

合肥顾中科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演/反路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>现场参加</div> <div><input type="checkbox"/>电话会议</div> <div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div>
来访单位名称	财通证券、融通基金、鹏扬基金、华泰证券、嘉实基金
时间	2026 年 2 月 4 日
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 问：公司火灾事故的说明？</p> <p>答：2026 年 1 月 24 日清晨，公司全资子公司顾中科技（苏州）有限公司厂区凸块制程段发生火灾事故。本次事故的事故中心位于苏州顾中 Fab#2 凸块制程段蚀刻区，事故造成火灾中心附近厂房及机器设备毁损，同时受事故产生的烟雾及灭火过程中用水影响，厂房区域内部分其他机器设备亦被毁损或需维修后使用。本次事故导致的损失主要为机器设备和厂房，初步判断属于保险合同约定的理赔范围。受本次事故影响，苏州顾中凸块制造产线暂时停产，订单交付能力阶段性下降，经初步估计，预计 2026 年度营业收入将较年初制定的财务预算增长幅度减少 5-8 个百分点。具体的内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日、2026 年 2 月 4 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥顾中科技股份有限公司关于全资子公司发生火灾事故的公告》（公告编号：2026-009）、《合肥顾中科技股份有限公司关于全资子公司发生火灾事故的进展公告》(公告编号：2026-012)。</p> <p>2. 问：公司对外投资禾芯集成的情况介绍？</p> <p>答：为优化公司战略布局，拓展集成电路先进封装测试领域业</p>

	<p>务协同，公司拟以自有资金人民币 5,000 万元对禾芯集成进行增资。本次投资完成后，公司认缴禾芯集成新增注册资本 2,600 万元，增资完成后将持有其 2.27%的股权，成为禾芯集成股东。</p> <p>公司作为国内集成电路高端封装测试领域的领军企业，参股专注于先进封测的禾芯集成，并非简单的资本布局，而是基于产业链协同的战略考虑。此次参股将从客户资源拓展、技术能力互补、先进封装生态完善三大维度，为公司构建了差异化竞争优势，进一步夯实在先进封测领域的行业地位。具体的内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥硕中科技股份有限公司关于对外投资浙江禾芯集成电路有限公司的公告》（公告编号：2026-007）。</p> <p>3. 问：公司的终端客户结构？</p> <p>答：公司主要终端客户京东方、华星光电、天马、维信诺等。</p> <p>4. 问：公司 2025 年第一季度净利润较以前年度降低很多的原因？</p> <p>答：主要原因如下：（1）合肥厂因处于产能爬坡期，当期相应的折旧及人工费用等固定成本及费用较上年同期有所增长；（2）在高效散热、高结合力等高性能芯片、车规级高稳定性铜柱芯片封装的研究、高刷新率及高分辨率显示驱动芯片的测试研究等先进集成电路封测领域，公司在继续扩充产能的同时持续加大研发投入，当期研发费用较上年同期有所增长；（3）为了吸引和留住优秀人才及核心骨干，公司实施限制性股票激励计划，当期相应摊销的股份支付费用较上年同期有所增长。</p> <p>5. 问：公司最近上市的可转换公司债券募投项目的整体规划？</p> <p>答：在显示驱动芯片封测领域，公司计划通过“高脚数微尺寸凸块封装及测试项目”的落地实施，提升显示驱动芯片铜镍金凸块的产能规模，同步扩大 CP、COG、COF 环节的产能供给。此举将进一步完善公司在显示驱动芯片封测业务的整体布局与产品矩阵，从而巩固在显示驱动芯片封测领域——尤其是铜镍金细</p>
--	---

	分领域的市场领先地位；在非显示类芯片封测领域，公司依托在凸块制造、晶圆减薄等工艺的深厚积累，积极布局“FSM（正面金属化）+BGBM（背面减薄与金属化）+Cu Clip（铜片夹扣键合）”的先进封装组合，建立载板覆晶封装（FC）制程，优化公司产品布局，拓宽功率芯片应用领域，本次募投项目的实施将有利于提升公司非显示类封测业务全制程服务能力，带动现有制程的业务拓展。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 2 月 5 日